

# 2022年度 第4回 光材料・応用技術研究会

日時 : 2023年 3月 3日(金) 13:00 - 17:00

会場 : 中央大学(後楽園) 3308号室(3号館3階)

(オンライン: Webexとのハイブリッド開催)

担当幹事: 多喜川 良(九州大学)、梅木 毅伺(NTT)、庄司 一郎(中央大学)

## テーマ: 低温接合による異種材料光集積・実装技術

世界の技術潮流である社会全体のデジタル化に向けて従来性能を凌駕する光電子デバイスが要求される中、半導体微細加工技術の限界によりMoore則の終焉が問われている。この現状を打破するために、異機能融合によるデバイスの多機能化に向けた新たな進化軸(More than Moore)にシフトしつつある。そのため、異種材料チップの混載及び3D積層技術による異種機能統合化への期待は大きい。本研究会では、キーテクノロジーとなる「多彩な異種材料チップの低温接合技術」をキーワードに、最新の光実装・集積技術とその光デバイス展開の最新動向について、大学及び民間企業の第一線の研究者にご講演いただき、本分野の基礎から応用まで学べる機会としたい。

### \*\*\*\*\* プログラム \*\*\*\*\*

13:00-13:10 代表幹事挨拶 山本 和久(大阪大学)

(講演)

1. 13:10-13:50 室温接合技術の基礎とヘテロ光集積・実装技術の研究動向  
多喜川 良(九州大学)

2. 13:50-14:30 次世代映像システムの実現に向けた3次元集積化技術と画素並列  
CMOSイメージセンサの開発  
後藤 正英(NHK放送技術研究所)

\*\*\*\*\* 休憩 (14:30~14:50) \*\*\*\*\*

3. 14:50-15:30 室温直接接合を用いた高輝度白色LEDの高効率化  
市川 将嗣(日亜化学工業)

4. 15:30-16:10 高効率太陽電池応用に向けた異種材料低温接合技術の開発  
田辺 克明(京都大学)

(国際会議報告)

5. 16:10-16:50 国際会議Photonics West 2023 参加報告

講師調整中

16:50-17:00 研究会からのお知らせ

## [お申込み・お問合せ]

- ・お問合せは光協会(担当: 開発部 間瀬)へ御連絡ください。
- ・参加申込み締切りは、2月24日(金)(厳守)です。
- ・E-mail: [omat@oitda.or.jp](mailto:omat@oitda.or.jp)、TEL: 03-5225-6431(代)、携帯電話(当日のみ): (準備中)

## [参加費]

- ・光材料・応用技術研究会会員 : 無料
  - ・会員同伴者(同部署、1名まで) : 3,000円
  - ・一般聴講者 : 15,000円
- 参加費は、銀行振込みにてお支払い願います。

## [会場で御参加の方へ: コロナ対策への御協力をお願い]

- ・常時マスクの着用をお願い致します。
- ・挨拶程度の会話を除き、講演会場内での会話はお控えください。
- ・会場内外を問わず、ソーシャルディスタンスの確保をお願い致します。

## [会場案内] 中央大学 後樂園キャンパス

住所: 〒112-8551 東京都文京区春日1-13-27

交通: 東京メトロ 丸の内線「後樂園駅」徒歩5分(出口4b)  
東京メトロ 南北線「後樂園駅」徒歩5分(出口4b、6)  
都営地下鉄 大江戸線「春日駅」徒歩5分(出口6)  
都営地下鉄 三田線「春日駅」徒歩7分(出口6)  
JR中央・総武線「水道橋駅」徒歩15分(出口西口)

### 中央大学 後樂園キャンパス バリアフリーマップ



幹事会会場  
3号館9F 3907号室  
研究会 会場  
3号館3F 3308号室